

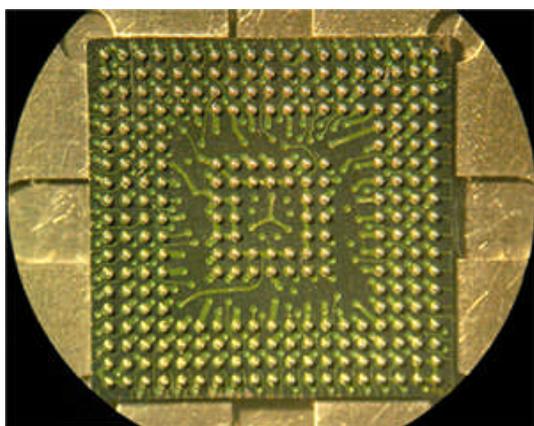
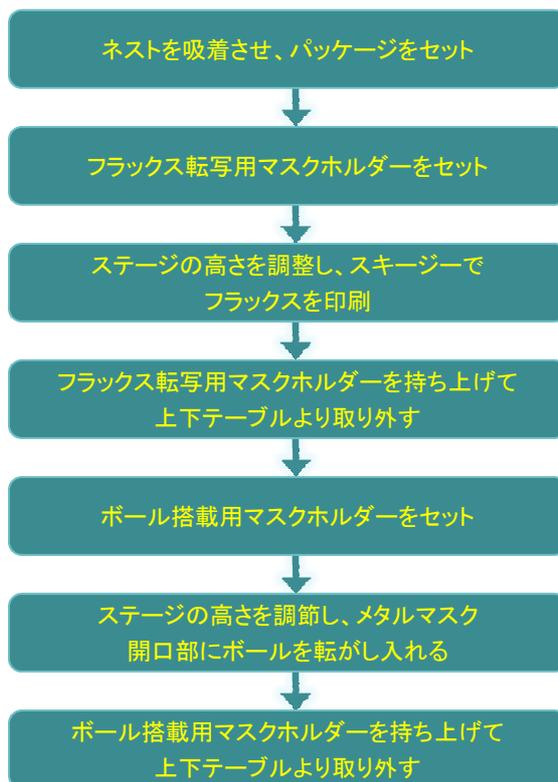
BGAリボールユニット SMU-50

メタルマスクを用いたBGAリボールユニット

精密リボールユニット SMU-50 は、BGAやCSPパッケージのリボール作業を簡単に行うことができます。メタルマスクをX、Y、θ方向に精度良く位置決めするためのマイクロアライメント機能を備えています。パッケージ表面とメタルマスク間の隙間をマイクロメーター指針により精密に調整することが可能で、ミスアライメントやミッシングボールを最小限に抑えることができます。また、マスクホルダーの交換や、メタルマスクのホルダーへの取り付け作業は容易に行え、メタルマスク交換で各種パターンに対応します。



プロセスフロー



0.3mm径はんだボール搭載



ボールマウント、及びはんだペースト印刷用マスクホルダー

詳細は、株式会社 シンアペックス 電子機器プロジェクト部門までお問合せ下さい。